

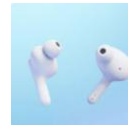
## 产品概述

该芯片内置高性能DSP 和 NPU，以支持复杂的多麦克风上行降噪算法和关键字唤醒，同时兼顾低功耗。集成 Hybrid ANC，可支持高带宽、深降噪的耳机应用。可提供丰富的接口，集成度高，适用于高级 TWS 降噪耳机和其他需要复杂的音频处理和语音 AI 能力的低功耗产品。

## 优势特性

- 支持BT/BLE 5.3双模协议栈；
- 支持LE Audio新技术标准和 LC3编解码器；
- 集成Hybrid混合式ANC主动降噪；
- 高集成度，实现内部触摸和入耳检测；
- 升级射频和音频相关性能。

## 应用领域：



TWS耳机



游戏耳机

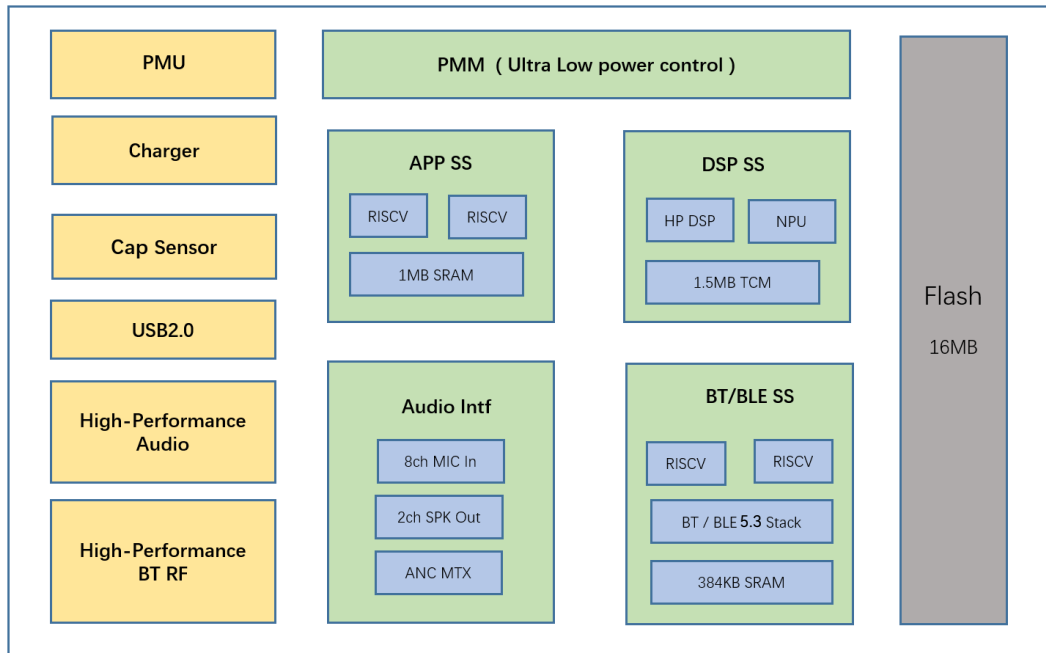


OWS耳机



蓝牙音箱

## 产品框图



版权所有 © 重庆物奇微电子股份有限公司 2023。保留一切权利。未经版权所有人的书面许可，本文档的任何部分不得转载。

### 免责声明

由于在方法、设计和制造方面的不断进步，本文档的内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，重庆物奇微电子股份有限公司对使用本文档所产生的任何错误或损害不负任何责任。